

2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策 专项资金申报指南

一、支持对象

在武汉市登记注册，具有独立法人资格的集成电路企业和集成电路设计企业。

集成电路企业需同时符合下列条件：

1. 主营业务为集成电路或半导体领域设计、制造、封测、设备、材料的企业。

2. 企业财务会计制度健全，税务征管关系在武汉市内，并依法纳税。

3. 不违反国家、省、市联合惩戒政策和制度规定，近三年无不良信用记录，符合国家、省、市能耗、环保、安全生产、产品质量等要求。

4. 有完整的全职研发团队，具备自主研发能力。

集成电路设计企业需同时符合下列条件：

1. 符合上述 4 条规定，并以集成电路设计为主营业务。

2. 拥有自主知识产权（如集成电路布图设计登记证书、发明专利授权等），并以此为基础开展经营活动。

3. 具有与集成电路设计相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境（如电子设计自动化（EDA）工具、开发工具等）、相关的技术支撑环境。

二、支持周期

支持周期即为后文所称“年度”，起止时间为：**2021年7月1日—2022年6月30日**（本政策属于后奖补政策，奖补依据为企业在支持周期内实际发生的费用）。

三、支持政策

企业可同时申报以下5项奖补政策。其中流片补贴、设计费用补贴仅限集成电路设计企业申报。

（一）流片补贴

1.对完成全掩膜（Full Mask）首轮工程产品流片的集成电路设计企业，给予首轮流片费用30%或首轮掩膜版制作费用50%的补贴，单个企业年度补贴总额最高500万元。

2.对使用多项目晶圆（MPW）流片进行研发的集成电路设计企业，给予MPW首轮流片费用50%的补贴，单个企业年度补贴总额最高100万元。

（二）设计费用补贴

1.给予购买IP、EDA实际支出费用的30%、年度总额最高200万元的补贴。

2.给予复用、共享我市第三方集成电路设计平台的IP设计工具软件或者测试分析系统实际投入的50%、年度总额最高100万元的补贴。

（三）集成电路公共服务平台建设资助和运营奖励

1.对新建的集成电路公共服务平台，一次性给予平台实际建设投入自有资金部分30%的资助，最高资助总额不超过1000万元。

2.对投入运营的集成电路公共服务平台，按年度市内中小企业服务合同实际完成额的30%给予奖励，单个平台每年最高不超过500万元。

（四）销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励

1.对于企业销售自主研发设计的芯片，且单款芯片年度销售金额累计超过500万元的，按照年度销售金额10%给予一次性奖励，单款芯片年度奖励最高不超过500万元。单个企业在政策有效期内奖励总额最高不超过1000万元。

2.企业销售自主研发生产的集成电路关键核心设备或材料，且单款设备或材料年度销售金额累计超过300万元的，按照年度销售金额30%给予一次性奖励，单款设备或材料年度奖励最高不超过500万元。单个企业在政策有效期内奖励总额最高不超过1000万元。

3.企业销售自主研发EDA软件，按照单款EDA软件年度销售金额50%给予一次性奖励，单款EDA软件年度奖励最高不超过500万元。单个企业在政策有效期内奖励总额最高不超过1000万元。

（五）企业贷款贴息

按企业年度实际支付银行贷款利息金额的50%给予贷款贴息，单个企业每年贴息金额最高不超过1000万元。

四、申报条件

（一）流片补贴

1.企业年度进行全掩膜（Full Mask）或多项目晶圆（MPW）首轮流片的。

2.经过 Full Mask 流片，达到设计要求后，可以提供给集成电路系统整机厂商进行芯片性能测试及示范应用的芯片产品，产品须获得集成电路布图设计登记证书。

3.“首轮流片”是指集成电路设计企业为某款芯片进行的第一次流片。

4.流片费具体包括：掩膜版制作费、用于首轮流片的晶圆购置费（不高于 25 片晶圆）、制造端 IP 授权费、测试加工费等。

（二）设计费用补贴

1.企业年度直接购买 IP、EDA 并用于研发。

2.企业年度复用、共享我市第三方集成电路（IC）设计平台的 IP 设计工具软件或测试分析系统。

3.购买 IP 不包含委托技术服务。

4.“IP”是指供应方提供的已形成知识产权并完成权属登记的，可直接用于二次开发的商品。“Foundry IP”指由代工厂提供的用于流片环节的 IP 模块。

5.“委托技术服务”是指，委托方提出技术需求，由供应方研发，之后就该项技术形成知识产权，权属由双方自行约定的。

（三）集成电路公共服务平台建设资助和运营奖励

1.经市级以上（含）科技、发改、经信部门认定的，提供 EDA 工具和 IP 核、设计解决方案、先进工艺流片、先进封测服务、测试验证设备等用于我市企业芯片研发支撑服务的。

2.正常运营服务，具有明确的发展规划、功能定位和管理机制，拥有相应的服务设施、专业技术和管理人才队伍；主要面向中小型集成电路设计企业提供服务，具有公共性、开放性和资源

共享性。

3.申报企业投入平台建设和运营的自有资金不低于总投资的30%，且有能为平台的后续建设提供资金；政府补贴资金不得用于流动资金和纳入财政经费保障人员的工资性支出。

（四）销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励

1.芯片及相关产品指以下四类产品：芯片、集成电路制造或测试设备、集成电路制造材料、EDA 软件。

2.企业销售自主研发设计的芯片，且单款芯片年度销售金额累计超过 500 万元的（依据会计准则核算）。

3.企业销售自主研发设计、生产制造的集成电路设备或材料，且单款产品年度销售金额累计超过 300 万元的（依据会计准则核算）。

4.企业年度销售自主研发设计的 EDA 软件产品。

5.企业销售的芯片须取得集成电路布图设计专有权，销售的其他产品须拥有自主知识产权。

6.是否单款芯片、设备、材料、EDA 软件，以名称、型号以及其他相关技术材料判定。

7.企业当年度申报奖励的销售产品在技术、功能、市场应用方面要有一定创新性，不能与过往年度申报奖励的销售产品相同。

（五）企业贷款贴息

1.企业年度为扩大研发、生产而新增的银行商业贷款，不包括企业获得的政策性银行贷款。

2.企业上一一年度的集成电路主营业务收入占企业收入总额的比例不低于 60%。

3.新增贷款是指年度内新核准并已发放的贷款。

4.对因逾期、违约等产生的费用一律不予补贴。

五、申报材料

企业应按申报项目分别填写制作申报材料，装订成册，于申报受理时限内提交纸质版三份及电子版至所属区（开发区）经信部门。

（一）流片补贴申报材料

1.《2022年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》（附件1）

2.《2022年度武汉市集成电路产业发展若干政策流片补贴申报书》（附件2）

3.市经信局要求的其他材料

（二）设计费用补贴申报材料

1.《2022年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》（附件1）

2.《2022年度武汉市集成电路产业发展若干政策设计费用补贴申报书》（附件3）

3.市经信局要求的其他材料

（三）集成电路公共服务平台建设资助和运营奖励申报材料

1.《2022年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》（附件1）

2.《2022年度武汉市集成电路产业发展若干政策公共服务平台建设资助和运营奖励申报书》（附件4）

3.市经信局要求的其他材料

(四) 销售自主研发设计的芯片及相关产品奖励申报材料

1. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》(附件 1)
2. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策销售奖励申报书》(附件 5)
3. 市经信局要求的其他材料

(五) 企业贷款贴息申报材料

1. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申报书》(附件 1)
2. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策贷款贴息申报书》(附件 6)
3. 市经信局要求的其他材料

六、申报流程

(一) 发布通知

市经信局向各区(开发区)经信部门发布资金申报通知。各区(开发区)经信部门向本辖区内企业转发资金申报通知。

(二) 申报受理

各区(开发区)经信部门组织本辖区内企业开展相关申报工作。申报企业在受理时间内向所属区(开发区)经信部门提交申报材料,受理时间详见资金申报通知,逾期不予受理。

附件:

1. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策专项资金申

报书》

2. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策流片补贴申报书》

3. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策设计费用补贴申报书》

4. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策公共服务平台建设资助和运营奖励申报书》

5. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策销售奖励申报书》

6. 《2022 年度武汉市集成电路产业发展若干政策贷款贴息申报书》

武汉市经济和信息化局

2022 年 6 月 30 日